

平成27年5月11日  
一般社団法人 日本電子デバイス産業協会  
事務局 小林 関 司

## 材料部品部会主催の第七回勉強会のご案内

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

来る6月22日(月曜日)に下記のテーマで材料部品部会主催の第七回勉強会を実施いたします。

日本の電子デバイス産業を発展させる為には国内外の動向を常に把握し次世代を見据えた電子デバイスの開発が望まれるところです。今回の勉強会では、三人の講師をお招きし国内外の動向、次世代の開発プロジェクトを中心に下記のテーマで勉強会を実施いたします。

今回の勉強会も大変貴重な機会ですので皆様多数のご参加をお待ちしております。

日時 平成27年6月22日(月) 13:00～16:20

場所 御茶ノ水めっきセンター 4F会議室 03-3814-5621 (代)  
東京都文京区湯島1-11-10 <http://www.tmk.or.jp/gaiyou.html>

### [プログラム]

13:00～14:30 「電子デバイスは2015年も生産、投資ともに上昇を続ける!!」

～～国内でも大型工場計画が順次浮上～～

講師 泉谷 渉氏/(株)産業タイムズ社代表取締役社長

14:30～15:10 「次世代自動車の将来像とカーエレクトロニクスの方向性」

講師 未定

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

(休憩)

15:20～16:20 「高耐熱透明絶縁フィルムを目指すバイオポリイミドの開発」

講師 金子達雄氏 (北陸先端科学技術大学院大学/准教授 工学博士)

(注) ご参加希望の方は別紙回答用紙にて、**6月15日までに**メールでお申し込みください。確認後メール返信いたします(定員を超えましたら、締め切らせていただきます)。当日、配布資料代としてNEDIA会員の方は1,000円/人を、また非会員の方は3,000円/人(資料代含む)を徴収いたしますのでご承知おきください。

以上